



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20111122000
2011 年 11 月 23 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

PWR SOIC (8DDA) パッケージ 一部製品 組立サイト追加のご案内

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

タイにおける大洪水の影響により、HANA 社(タイ)サイトを含む数カ所の弊社協力工場における生産が、暫定的に被害を受けております。

TI は、連日、生産/流通拠点パートナーからの状況連絡を受けながら、供給面での致命的影響を緩和する為に、代替製造工場の選定及び認定を含む様々な施策を行っております。

今回のお知らせは、代替組立検査工場追加の連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為に、本通知内で明記したパッケージ製品について、追加工場への生産移管に向け早急に対応いたしております。

TI は、現行最善の情報/知識に基づき生産移管に必要な全てを本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、変更があった場合にも同様に本通知の更新版にて連絡いたします。さらに、選定された代替工場をより効率的に利用できると判断した時点で、これらに関連する供給移管に伴う PCN を発行する場合があります。

TI は、各生産拠点での認定状況を基に生産拠点選定及びパッケージ認定試験による前述の移管施策に加え、お客様への製品納入に先立ち、選別工程での歩留まり/選別分類比較評価を行う事でお客様での懸念事項の払拭に向け進めてまいります。また、供給の遅れを最小限にとどめると共に、品質を伴った製品の供給に努めてまいります。

次ページに詳細を掲載いたしました。お客様におかれましては、本通知発行日より **21 日**以内に、本通知受領のご確認をお願いいたします。供給遅延を最小限にとどめるために、TI は部材供給可能な代替工場での生産を 12 月の出荷が開始されるべくすでに施策の実施を開始いたしました。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	PWR SOIC (8DDA) パッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行 : HANA 社(タイ) 変更後 : HANA 社(タイ), AMKOR 社(フィリピン)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12 月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 PWR (パワーマネジメント) SOIC (8DDA) パッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 HANA 社(タイ) サイトにて製造していますが、HANA 社(タイ) サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為に、これに加えて、AMKOR 社(フィリピン) サイトを追加します。組立部材変更については下表を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
組立サイト

現行
HANA 社(タイ)

変更後
HANA 社(タイ)
AMKOR 社(フィリピン)

	現行	追加認定
組立サイト	Hana-Thai	Amkor-Philippines
チップ接着剤	400159	101306338

理由：HANA 社(タイ) サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名			
HPA00182DDAR	TPS5430DDA	TPS5431DDA	TPS5450DDA
HPA00295DDAR	TPS5430DDAG4	TPS5431DDAG4	TPS5450DDAG4
HPA00393DDAR	TPS5430DDAR	TPS5431DDAR	TPS5450DDAR
HPA00789DDAR	TPS5430DDARG4	TPS5431DDARG4	TPS5450DDARG4

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び製品捺印が下記のようになります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	Hana-Thai	ASO: HNT
追加認定	Amkor-Philippines	ASO: AKR



図1 出荷ラベルの例

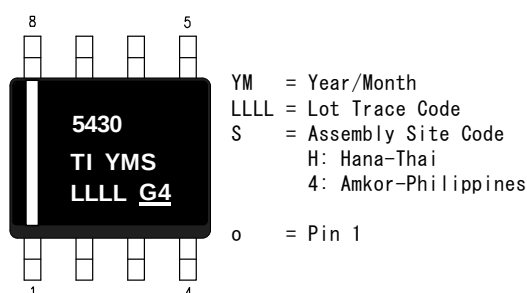


図2 製品捺印の例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2011 年 11 月	終了	2011 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS5430DDA	-	-	
Assembly Site:	AMKOR AP1	Package/Code/Pins:	SOIC/DDA/8	
Mount Compound:	101306338	Mold Compound:	101323396	
Bond Wire (Mils):	2.0 mil, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	
Electrical Characterization	-	30	-	
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 11 月 10 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS54327DDA	-	-	
Assembly Site:	AMKOR AP1	Package/Code/Pins:	SOIC/DDA/8	
Mount Compound:	101306338	Mold Compound:	101323396	
Bond Wire (Mils):	2.0 mil, Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Electrical Characterization	-		30/0	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		Approved	
**Biased Temp. Humidity	85C/85%RH, 168, 500, 1000 Hrs		26/0	
X-ray	top side only		5/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Bond Pull	76 Wire, 3 units min		6/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		12/0	
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				